

南台科技大學 102 學年度第 2 學期課程資訊

課程名稱	積體電路封裝
課程編碼	L0D08901
系所代碼	0L
開課班級	四技光電四甲 四技光電四乙
開課教師	涂瑞清
學分	3.0
時數	3
上課節次地點	四 6 7 8 教室 N001
必選修	選修
課程概述	介紹積體電路封裝原理及其應用
課程目標	使同學對於封裝技術之發展及及各類封裝技術在產業應用之深刻之認知
課程大綱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 封裝技術與發展簡介 2. IC 封裝製程 3. IC 封裝元件的分類 4. 封裝材料的介紹 5. 新世代封裝技術 6. IC 元件的挑戰/發展 7. CAE 在 IC 封裝製程的應用
英文大綱	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overview of packaging technology and development 2. IC packaging process 3. Classification of IC packaged devices 4. Packaging materials 5. New-era packaging technology 6. Challenge and development of IC device 7. Applications of CAE on IC packaging
教學方式	
評量方法	
指定用書	
參考書籍	
先修科目	
教學資源	
注意事項	
全程外語授課	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	

輔導考照 1	
輔導考照 2	